

高云的产品变更通知（GPCN）

概述

感谢您使用高云 FPGA 系列器件，此通知的目的是通知受此变更影响的客户注意此次变更，本次变更是为了提升产品质量。

描述

PBGA256 封装产品的塑封料由 KE-G1250LKDS-U2M CL20 变更为 KE-G1250LKDS CL20。

变更前	1、塑封料供应商：京瓷株式会社 2、塑封料型号：KE-G1250LKDS-U2M CL20
变更后	1、塑封料供应商：京瓷株式会社 2、塑封料型号：KE-G1250LKDS CL20

受影响的产品

使用 KE-G1250LKDS-U2M CL20 塑封料的 PBGA256 封装产品（见附表 1 产品型号清单）。

关键日期

此次变更与 PCN 生效时间同步，自 2023 年 02 月 02 日开始执行，当前产品的 LTB 及 LTS 为 2023 年 05 月 01 日。

响应

请客户确认已收到此通知，如对此变更有任何问题或顾虑，请通知我们。如 30 日内没有响应，将默认已接受此变更。

附加文件

附表 1：产品型号清单

序号	封装形式	产品型号
1	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-LV4PG256
2	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-UV4PG256
3	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-LV9PG256
4	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-UV9PG256
5	LFBGA(17*17-1)256	GW2A-LV18PG256
6	LFBGA(17*17-1)256	GW2A-LV18PG256C
7	LFBGA(17*17-1)256	GW2A-LV18PG256CF
8	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-LV4PG256M
9	LFBGA(17*17-1)256	GW1N-UV4PG256M
10	LFBGA(17*17-1)256	GW2A-LV18PG256S
11	LFBGA(17*17-1)256	GW2A-LV18PG256SF
12	TFBGA(17*17-0.8)332	GW1N-LV9UG332
13	TFBGA(17*17-0.8)332	GW1N-UV9UG332

技术支持与反馈

广东高云半导体科技股份有限公司提供全方位技术支持，在使用过程中如有任何疑问或建议，可直接与公司联系：

网站：www.gowinsemi.com.cn

邮箱：support@gowinsemi.com

版本信息

日期	版本	说明
2022/11/02	1.0	初始版本。

版权所有©2022 广东高云半导体科技股份有限公司

GOWIN高云、Gowin、GowinSynthesis、云源以及高云均为广东高云半导体科技股份有限公司注册商标，本手册中提到的其他任何商标，其所有权利属其所有者所有。未经本公司书面许可，任何单位和个人都不得擅自摘抄、复制、翻译本档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

免责声明

本文档并未授予任何知识产权的许可，并未以明示或暗示，或以禁止发言或其它方式授予任何知识产权许可。除高云半导体在其产品的销售条款和条件中声明的责任之外，高云半导体概不承担任何法律或非法律责任。高云半导体对高云半导体产品的销售和 / 或使用不作任何明示或暗示的担保，包括对产品的特定用途适用性、适销性或对任何专利权、版权或其它知识产权的侵权责任等，均不作担保。高云半导体对文档中包含的文字、图片及其它内容的准确性和完整性不承担任何法律或非法律责任，高云半导体保留修改文档中任何内容的权利，恕不另行通知。高云半导体不承诺对这些文档进行适时的更新。